

調査速報

台湾電子関連企業売上高（2019年12月）

5G関連需要の立ち上がりを待つ展開

主任研究員  
山鹿 亜紀子  
045-225-2375  
[yamaga@yokohama-ri.co.jp](mailto:yamaga@yokohama-ri.co.jp)

要約

- 台湾電子関連企業65社の12月売上高は、前年同月比4.0%減。11月の同1.8%減からマイナス幅が拡大するも、これは寄与度の高い鴻海精密工業（ホンハイ）の売上が減少したことによる。
- ホンハイを除いた64社の売上高は、同1.9%増と3か月ぶりにプラスに転じた。分野別には、半導体関連企業が引き続き好調なほか、サーバ関連企業や電子部品企業も回復基調にある。
- 2020年の回復を牽引するのは5G関連。当面はこの需要の立ち上がりを待つ展開となろう。

1. 台湾電子関連企業の12月売上高は、寄与度の高い鴻海精密工業の売上が減少し、前年割れ

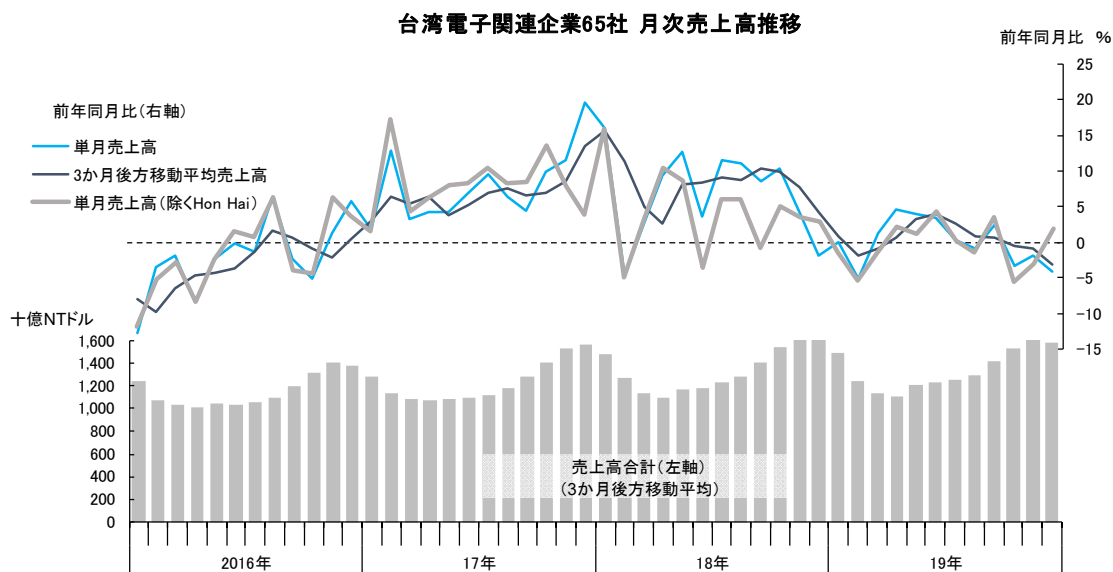
台湾は電子部品産業が集積している。また、台湾企業の月次売上高は翌月中旬に公表されるため、速報性が高く、電子部品産業の動向を示す先行指標となっている。

浜銀総研が抽出した、台湾の代表的な電子関連企業65社の12月の売上高合計は、前年同月比4.0%減（前月比7.8%減）と、3か月連続でマイナスとなり、また、そのマイナス幅も11月の前年同月比1.8%減から拡大した。

マイナス幅が拡大した要因は、全体への寄与度が最も高い鴻海精密工業（ホンハイ）の売上高が、同12.9%減となったことによる。ホンハイの減少は、12月15日に発動予定であった米国による対中制裁第4弾（12月13日に撤回）を回避するための前倒し出荷の反動減や、顧客の出荷時期の調整などがあったためと推測している。

ホンハイを除いた64社の12月売上高は、前年同月比1.9%増（前月比6.2%減）と3か月ぶりに増加した。分野別には、半導体関連がファウンドリ最大手のTSMCを筆頭に好調なほか、電子部品企業やサーバ関連企業の売上も回復基調にある。ただし、エレクトロニクス製造の下流工程に属するEMS各社の売上高は、ホンハイ以外の企業でも総じて軟調であり、前倒し出荷の反動減の影響などが出ている可能性がある。

図表1 台湾電子関連企業の12月売上高は3か月連続で前年同月比マイナス



注: 台湾企業65社はTWSE(台湾証券取引所)に上場している電子関連の代表的な企業を浜銀総合研究所が抽出。  
出所: Taiwan Stock Exchange, M.O.P.S.より浜銀総合研究所作成

これらの前倒し出荷の反動減は一時的なものと考えるが、台湾電子関連企業全体の「実質的な回復」を確認できるのは、春節の大型連休の影響（2020年は1月24日～1月30日、2019年は2月4日～2月10日）が無くなる3月以降と見込む。（「実質的な回復」と記述した理由は、春節休暇のタイミングにより、2019年と比較して2020年の1月は稼働日数が少なく、2月は稼働日数が長くなるためである。）回復の背景となるのは5G（第5世代移動通信）関連であり、2020年前半は5G基地局関連の需要が、年中盤から後半にかけては、5G端末関連の需要が回復を牽引すると見込んでいる。当面は、これらの需要の本格的な立ち上がりを待つ展開となろう。

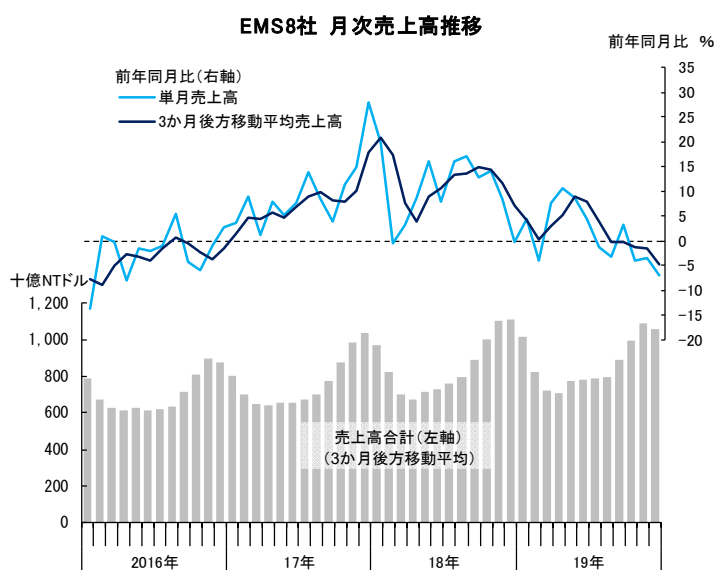
## 2. 下流工程のEMSは軟調ながらも、半導体や電子部品などの上～中流工程は堅調【EMS】

EMS（Electronics Manufacturing Service、電子機器の受託製造サービス）8社の12月の売上高合計は、前年同月比6.9%減（前月比8.4%減）となった（図表2）。11月の前年同月比3.4%減から減少率が拡大した理由は、前述の通り、ホンハイの売上高が同12.9%減と大きく減少したためである。また、ホンハイ以外の7社中5社の売上高も前年同月比で減少しており、これらの企業でも、前倒し発注の反動減があった可能性がある。後述する半導体や電子部品といったEMSより上流工程に属する企業の動向が好調なことから、顧客の需要動向は悪くはないと推測されるが、EMSの実質的な回復を確認できるのは、春節の大型連休の影響がなくなる3月以降となろう。

### 【半導体】

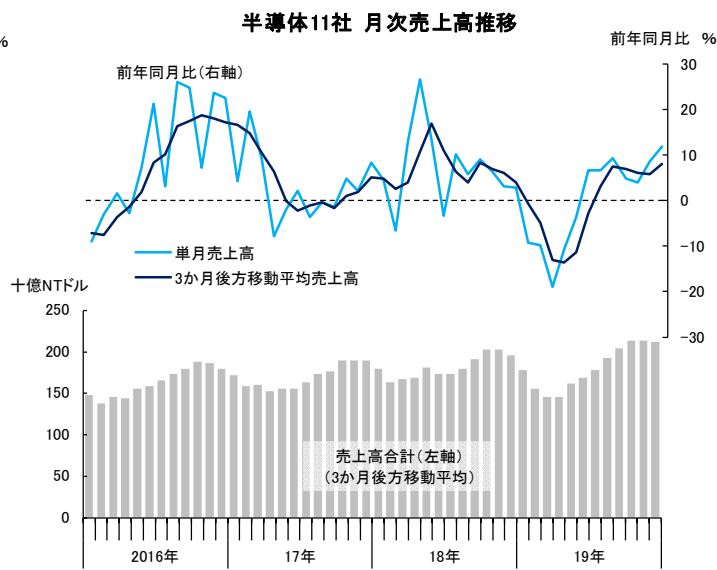
半導体企業11社の12月の売上高合計は、前年同月比11.9%増（前月比1.7%減）となった（図表3）。ファウンドリの世界最大手のTSMCの売上高は、前年同月比15.0%増となり、全体の回復を牽引した。TSMCは、5G向けや高性能計算向けの最先端半導体の製造を手掛けており、米Apple（アップル）や米Qualcomm（クアルコム）、中国Huawei（ファーウェイ、華為）、米NVIDIA（エヌビディア）等からの受注が殺到している模様である。またTSMC以外の半導体企業も、10社中9社が前年同月で増加し、半導体の工程別・種類別でも、前工程、後工程、LSI設計、メモリの全工程で前年同月比プラスとなった。

図表2 EMSは前倒し発注の反動減で前年割れ



注: 8社は、Hon Hai Precision、Pegatron、Compal Electronics、Wistron、Inventec、Qisda、Kinpo Electronics。  
出所: Taiwan Stock Exchange, M.O.P.S.より浜銀総合研究所作成

図表3 半導体は全工程で回復

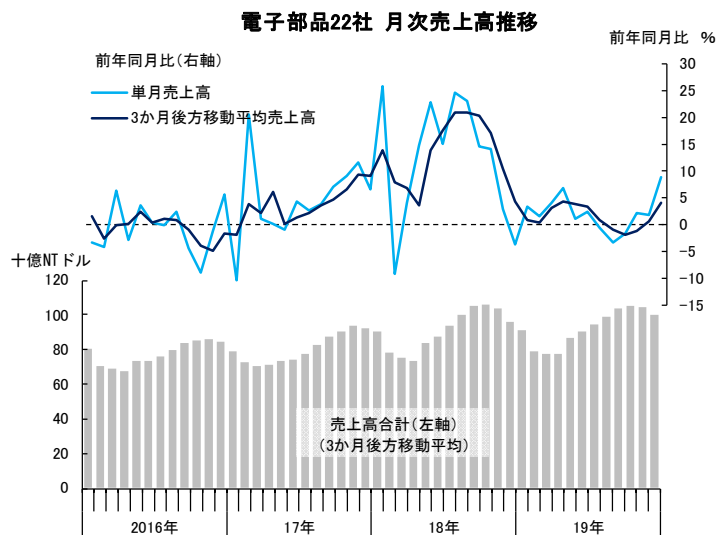


注: 11社は、United Microelectronics、Taiwan Semiconductor Manufacturing、ASE Technology、King Yuan Electronics、Nanya Technology、Winbond Electronics、Macronix International、MediaTek、Novatek Microelectronics、Realtek Semiconductor  
出所: Taiwan Stock Exchange, M.O.P.S.より浜銀総合研究所作成

【電子部品】

電子部品22社の12月売上高合計は、前年同月比8.9%増（前月比6.5%減）となり、3か月連続のプラスとなった（図表4）。プリント配線板企業やパワーサプライ企業が回復傾向にあることに加え、受動部品（コンデンサ、抵抗器等）企業の減少率も縮小傾向になったことが、回復の背景である。

図表4 電子部品は3か月連続で増加



注: 22社は、Zhen Ding Technology、Unimicron Technology、Tripod Technology、HannStar Board、Nan Ya Printed Circuit Board、Global Brands Manufacture、Kinsus Interconnect Technogy、Chin-poon Industrial、Flexium Interconnect、Gold Circuit Electronics、Compeq Masufaturing、Elite Material、ITEQ、Taiwan PCB Techvest、Yageo、Walsin Technology、Delta Electronic、Chicony Power Technology、Cheng Uei Precision、Chicony Electronics Industry、Pan-International Industrial、Primax Electronics  
出所: Taiwan Stock Exchange,M.O.P.S.より浜銀総合研究所作成

本レポートの目的は情報の提供であり、売買の勧誘ではありません。本レポートに記載されている情報は、浜銀総合研究所・調査部が信頼できると考える情報源に基づいたものですが、その正確性、完全性を保証するものではありません。